

イオンマイグレーション及び絶縁特性の評価

イオンマイグレーションは、金属や電導性皮膜が絶縁材料と接している場合、電界と吸湿下において金属が絶縁材料の表面や内部に移行して絶縁不良を引き起こす現象です。この現象は複雑な要因が多く、判定が難しいため、正しい精度の高い試験を行い、信頼性の高いデータを得ることが重要になります。プリント配線板や集積回路の多層・高密度・ファインピッチ化に対応した基板や材料・部品の信頼性評価のために、このイオンマイグレーション試験が必要になってきます。



マイグレーション試験機



★最大 3kV までの高電圧印加可能

印加電圧を 3V~3kV の範囲からお選びいただけます。

★保有チャンネル数およそ 500ch

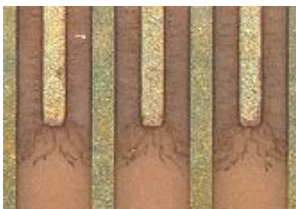
豊富なチャンネル数で、多測定点での試験が可能です。

★瞬間的な絶縁抵抗値の低下も測定

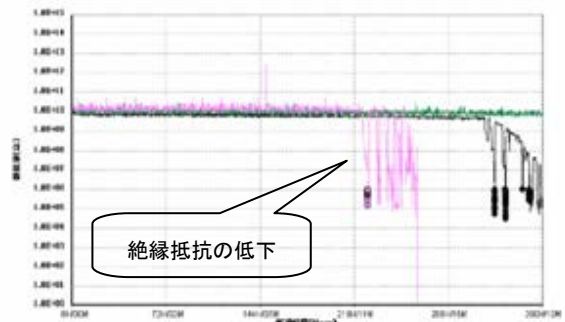
試験中の絶縁抵抗値を 1/100 秒の単位でモニターし、瞬間的な絶縁抵抗値の低下も逃さずキャッチします。

★様々な環境試験での対応可能

85°C/85%RH での高温高湿条件下や温湿度サイクル試験、HAST 試験中での測定が可能です。



マイグレーション発生例
(デンドライト)



絶縁抵抗測定例

マイグレーション試験
パターン例(くし型)



□追加料金なしで、サンプル受領後、即日遅くとも翌日には試験を開始し、お急ぎの試験にも対応いたします。

□試験途中の測定結果も、お客様の必要なときに、必要な形式で報告させていただきます。

□ご希望により事前に打ち合わせを行いますので下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先

Chemitox 株式会社ケミトックス

URL: <http://www.chemitox.co.jp>

東京本社/〒145-0064 東京都大田区上池台 1-14-18

Tel: 03-3727-7111/Fax: 03-3728-1710

PWB/デバイス信頼性評価事業部

住田 (to-sumida@chemitox.co.jp)